

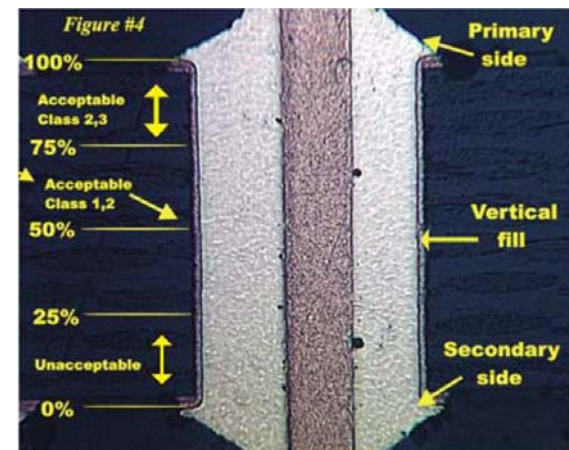
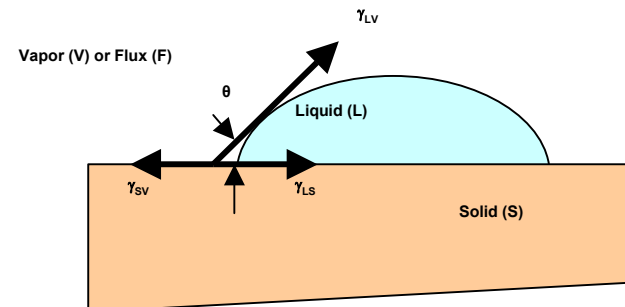
# SACX™ 合金

与SN100C 和 SAC305  
合金的孔填充性能比较

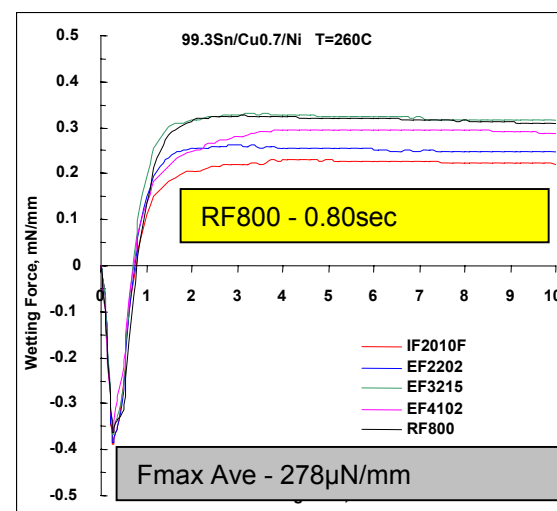
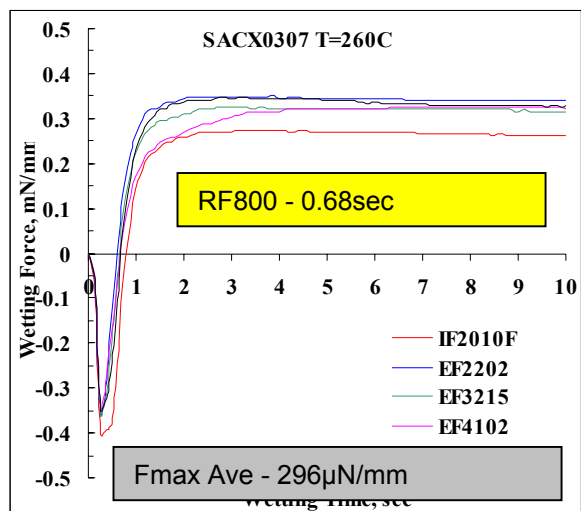
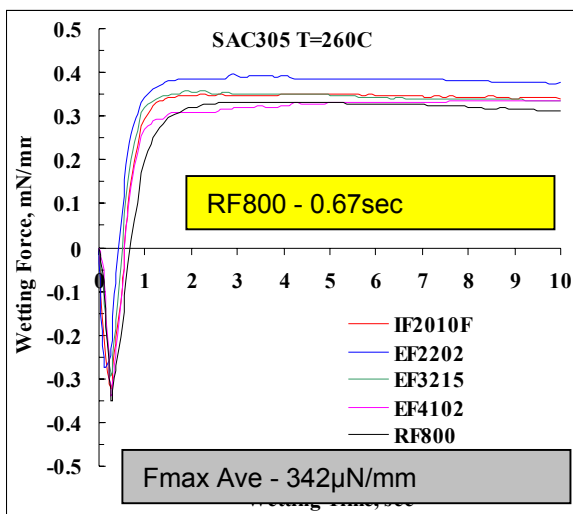


# 孔填充

- 孔填充与合金/助焊剂/表面最终处理组合的润湿性能有着紧密的关系。
- 当浸润速度和力量高的时候，我们可以期待更好的孔填充 – 其他参数相同。
- 比较浸润平衡测试结果，很大程度上代表了孔填充能力。

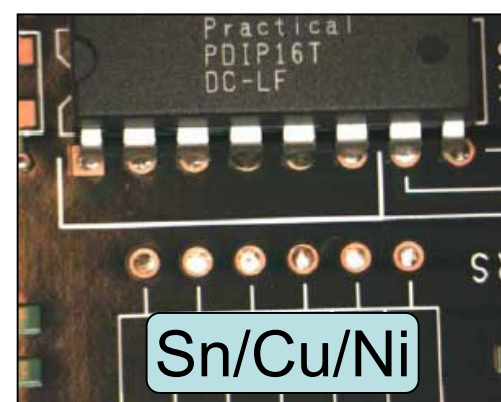
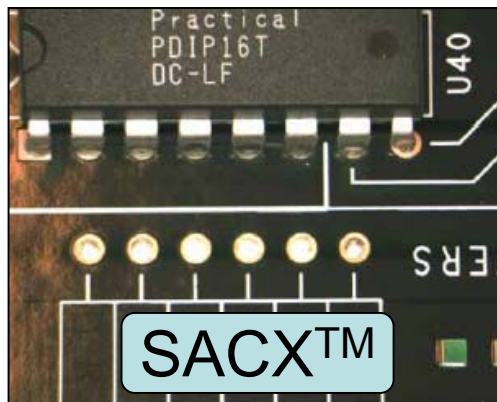
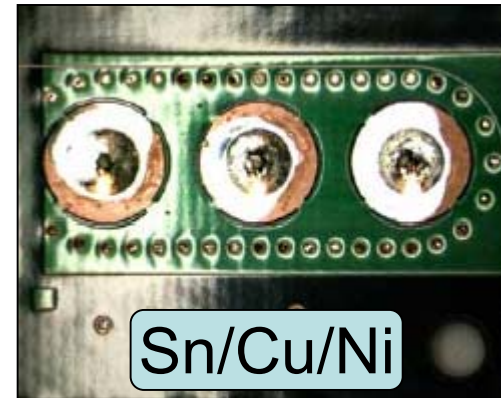


# 孔填充



- 使用Alpha RF800助焊剂 (主要的酒精基助焊剂) ，SACX™ 的浸润速度与SAC305相同。
- SACX™ 浸润速度较SN100C合金快 **18%** ，使用RF800 助焊剂。

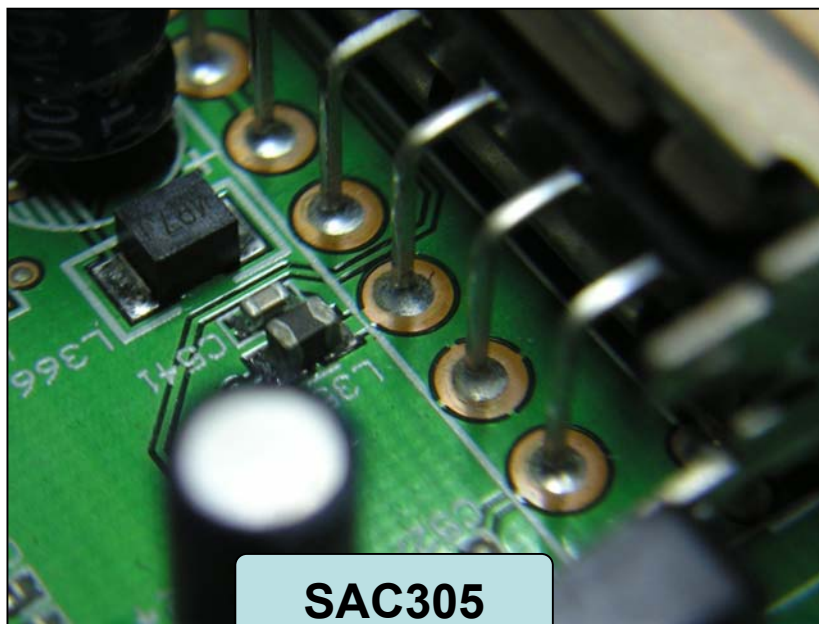
# 孔填充 - SACX v's Sn/Cu/Ni



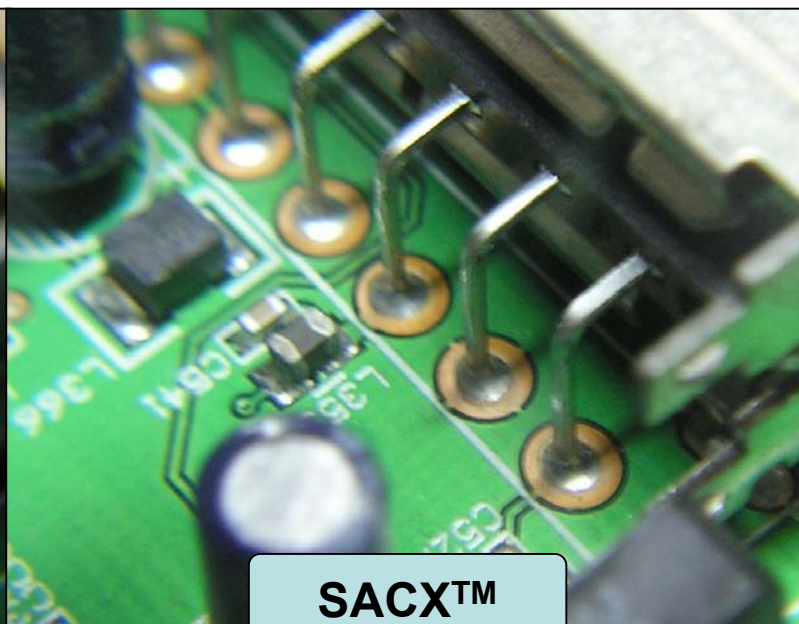
- 对比测试, 客户测试板
- 合金温度: 260°C
- 接触时间: 3.3秒
- 波峰: Soltec Smart wave
- 气体: 空气
- 焊盘处理: CuOSP
- **结果: SACX™ 的孔填充效果好于SN100C**

SACX™ 孔填充性能更好

# 孔填充 SACX v's SAC305



SAC305



SACX™

- LCD TV 主板- 一次回流.
- CuOSP 焊盘表面处理
- 传送速度120cm/min
- 温度 260°C
- 顶面温度 120°C, 底面温度 164 °C
- 助焊剂 – 水基不含松香ORM0
- Soltec Delta – 波峰部分氮气保护

- **SACX™** 的孔填充与 **SAC305** 相同。



## 结论

- 浸润性能和孔填充性能关系非常紧密。
- **SACX™** 较**SN100C**有着更好的孔填充性能  
- 基本的浸润特性决定了结果。
- **SACX™** 可以提供与**SAC305**相同的孔填充性能。